

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话/网络会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者
时间	2024 年 09 月 06 日 16:00-17:00
地点	同花顺路演平台
上市公司接待人员姓名	董事长邱国良先生 董事兼总经理刘小宁先生 财务总监宋开屏女士 董事会秘书邱靖琳女士 独立董事谢园保先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、各位领导好，贵公司净利润较去年同期有所下降，请详细解释下降的具体原因是什么？</p> <p>答：您好！公司 2024 年上半年度净利润同比下降，主要系营收结构变化导致综合毛利率的下降，毛利率较高的锡膏印刷设备营收占比较去年同期下降，毛利率较低的封装设备营收占比较去年同期上升。同时，报告期内软件退税、政府补助减少，长期应收款余额增加导致的计提坏账准备增加对利润也有一定影响。感谢您的关注！</p> <p>2、在“天眼查”查询到近期贵司申请了“一种电池片印刷设</p>

备”专利，是不是说明贵司已经进入光伏行业？是否有相关订单产生？谢谢

答：您好！公司正在提交申请“一种电池片印刷设备”方面的发明专利，公司也在继续跟进这方面的课题研究和开发。感谢您的关注！

**3、贵司在“智能穿戴”领域和"ai 眼镜"领域有没有相关的技术储备或产品？有没有相关领域的客户？**

答：您好！公司主要从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务，主要产品为锡膏印刷设备、点胶设备、封装设备和柔性自动化设备。其中，锡膏印刷设备、点胶设备及柔性自动化设备应用于电子工业制造领域的电子装联环节，电子装联下游以电子产品制造商为主，一般用到 PCB、FPC 和电子元器件的地方均会涉及到电子装联。公司在电子装联行业深耕多年，品牌知名度较高，获得了包括富士康、华为、鹏鼎控股、比亚迪、台表集团、仁宝集团、传音控股、光弘科技、华勤、德赛电池、东京重机、伟创力、捷普、木林森等各下游领域龙头客户的订单和认可，产品销往全球五十多个国家和地区。感谢您的关注！

**4、贵司在固态电池领域有没有相关的技术储备或产品？谢谢**

答：您好！公司主要产品为锡膏印刷设备、点胶设备、封装设备和柔性自动化设备。其中，锡膏印刷设备、点胶设备及柔性自动化设备应用于电子工业制造领域的电子装联环节，下游应用广泛，可应用于消费电子、汽车电子、网络通讯、航空航天、医疗器械、智能家居等行业的生产制造。封装设备主要应用于电子工业制造领域的封装环节及半导体封装环节，可应用于 LED 照明及显示器件、半导体芯片封装环节。感谢您的关注！

**5、贵司的产品有没有涉及折叠屏领域，有哪些相关的合作**

**方，谢谢**

答：您好！公司主要从事自动化精密装备的研发、生产、销售及技术支持服务，主要产品为锡膏印刷设备、点胶设备、封装设备和柔性自动化设备。柔性屏制造过程涉及众多工艺步骤，特别是在柔性电路板（FPC）的组装环节，表面贴装技术（SMT）扮演着重要角色，SMT 工艺离不开专业的电子装联设备。此外，对于采用 LED 芯片作为光源的户内及户外柔性商显屏，公司能够提供多种封装方式的产品，以满足 LED 光源封装的多样化需求。感谢您的关注！

## **6、未来的主业发展前景**

答：公司是国家级高新技术企业，国家制造业单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业。

1、坚定落实公司“共享技术平台+多产品+多领域”的研发布局，实现公司产品从单个“单项冠军”迈向多个“单项冠军”的战略，将各个事业部的产品方向从 SMT 向泛半导体 COB 及半导体封装领域衍生。

2、巩固单项冠军锡膏印刷设备的市场领导地位，推进产品迭代升级，继续保持产品品质、工艺方案及技术支持等多方面的竞争优势。在传统 LED 固晶机出货量取得突破之后，继续推进产品优化及供应链降本增效，扩大交付边际效应，提升产品毛利率；充分发挥公司固晶机在芯片小型化趋势上设备效率及稳定性的竞争优势，加大力度拓展 Mini/Micro LED 固晶机客户，提升市场占有率。技术的沉淀、产品的升级增强了点胶设备的核心竞争力，公司充分发挥在电子装联行业的品牌影响力及客户协同效应，稳步提升市场占有率。

3、增加应用于泛半导体及半导体产品的资源投入，积极引进行业专业人才提高产品性能，提升新产品的开发能力和渠道拓展能力。感谢您的关注！

## 7、跌成啥样了，都血亏

答：您好！

1. 公司积极践行“提质增效”，通过管理、研发、市场营销、产品拓展等方面多措并举，不断提升经营质量。管理方面，持续推进公司管理体系的信息化、数字化建设，完善和优化工作流程，构建公司运营与管理方面的竞争优势。市场营销方面，通过探索新媒体营销方式扩大产品知名度和品牌影响力。产品拓展方面，通过充分发挥电子装联行业的客户协同效应，深挖客户的潜在需求。

2. 公司始终将技术创新作为公司可持续发展的基石，一方面持续创新优化现有技术，提升产品性能，完善公司核心技术体系；另一方面结合产品及行业发展趋势，在现有技术基础上往高端制程延展，挖掘创新点，进行技术储备。2022 年度、2023 年度和 2024 年上半年度研发投入占营业收入的比例分别为 9.13%、10.06%和 10.10%。

3. 公司积极开展投资者关系管理工作，将一如既往地扎实做好主业经营，不断提升公司的盈利水平和可持续发展能力，推动公司价值成长。同时将通过互动易、投资者热线、股东大会等多种渠道和方式与投资者保持良好沟通和交流，积极传达公司信息，增进投资者对公司的了解和认同，促进市场对公司的价值发现。感谢您的关注！

## 8、为什么跌跌不休

答：您好！公司积极开展投资者关系管理工作，将一如既往地扎实做好主业经营，不断提升公司的盈利水平和可持续发展能力，推动公司价值成长。同时将通过互动易、投资者热线、股东大会等多种渠道和方式与投资者保持良好沟通和交流，积极传达公司信息，增进投资者对公司的了解和认同，促进市场对公司的价值发现。感谢您的关注！

## 9、怎么不保护股价呢

答：您好！

1. 公司积极践行“提质增效”，通过管理、研发、市场营销、产品拓展等方面多措并举，不断提升经营质量。管理方面，持续推进公司管理体系的信息化、数字化建设，完善和优化工作流程，构建公司运营与管理方面的竞争优势。市场营销方面，通过探索新媒体营销方式扩大产品知名度和品牌影响力。产品拓展方面，通过充分发挥电子装联行业的客户协同效应，深挖客户的潜在需求。

2. 公司始终将技术创新作为公司可持续发展的基石，一方面持续创新优化现有技术，提升产品性能，完善公司核心技术体系；另一方面结合产品及行业发展趋势，在现有技术基础上往高端制程延展，挖掘创新点，进行技术储备。2022 年度、2023 年度和 2024 年上半年度研发投入占营业收入的比例分别为 9.13%、10.06%和 10.10%。

3. 公司积极开展投资者关系管理工作，将一如既往地扎实做好主业经营，不断提升公司的盈利水平和可持续发展能力，推动公司价值成长。同时将通过互动易、投资者热线、股东大会等多种渠道和方式与投资者保持良好沟通和交流，积极传达公司信息，增进投资者对公司的了解和认同，促进市场对公司的价值发现。感谢您的关注！

## 10、邱总你好，公司毛利率下降请问这是否与市场竞争加剧或成本上升有关？公司采取了哪些措施来应对毛利率下降？

答：您好！公司营收占比较高的业务毛利率均有一定的增长，但产品销售结构变化导致综合毛利率有所下降。报告期内，公司综合毛利率为 32.29%，同比小幅下降 3.97 个百分点，主要受到公司产品销售结构变化的影响，毛利率较低的封装

设备增长较快，营收占比提升较多。营收占比较高的业务毛利率均有一定的增长，锡膏印刷设备毛利率同比上升 1.34 个百分点，封装设备毛利率同比上升 3.63 个百分点。公司将继续优化产品，迭代升级产品性能，保持产品市场地位和竞争力，同时通过技术创新、供应链的管理和市场细分领域的深耕以期提高产品毛利率，感谢您的关注！

**11、公司在研发方面的投入是否有变化？这些投入预计会如何影响未来的业绩表现？**

答：您好！2024 年半年度，公司坚定落实“共享技术平台+多产品+多领域”的研发布局，实现产品从单个“单项冠军”迈向多个“单项冠军”的战略。

研发团队以项目为主导，以客户需求为基础，在产品和技术方面均取得一定突破。锡膏印刷设备方面，新推出 G-Ace 系列全自动锡膏印刷机，该系列可集成自动换钢网、RFID、温湿度管控、中控中心等多项智能化应用，采用全新 UI 设计支持生物识别、智能人机交互及生产指标可视化管控，满足 30umGAP 间距印刷能力，主要应用于 BGA、SiP、3D、IGBT、Mini LED 等封装印刷；点胶机方面，新推出 DH8 双臂高速点胶机，该机型支持单头单轨、单头双轨、双头同步单轨、双头异步单轨等多种工作模式，多模式灵活切换支持多种不同点胶工艺需求，主要应用于 CCS 集成母排、汽车电子、通信网络、3C 笔电等领域；封装设备方面，新推出 GDM02H 固晶机，采用双轨式一体成型设计，集自动换晶环、吸嘴清洁、底部飞拍、扫码功能等多项智能化应用，可满足多种芯片混晶、混固、排晶等特殊工艺，主要应用于半导体、MiP、Mini LED、Micro LED、CSP 芯片制程等领域。感谢您的关注！

**12、请问，营业收入有显著增长，请问这种增长主要来源于哪些产品或服务？以及增长的主要驱动因素是什么？**

答：2024年上半年，封装设备和点胶设备的营收增幅较大，锡膏印刷设备的营收小幅下滑，公司整体营收实现增长。锡膏印刷设备实现营业收入19,014.68万元，同比下降6.38%，报告期内出货量有所增长，但部分设备未验收，对当期营业收入有一定影响。封装设备实现营业收入9,676.97万元，同比增长297.96%，经过多年的技术沉淀，LED封装设备逐步获得下游客户的认可，市场渗透率进一步提升。点胶设备实现营业收入4,789.72万元，同比增长72.04%，主要系技术的沉淀、产品的升级增强了点胶设备的核心竞争力，公司充分发挥在电子装联行业的品牌影响力及客户协同效应，市场占有率得到稳步提升。感谢您的关注！

**13、董秘你好，公司面临的主要风险有哪些？如何管理和减轻这些风险？**

答：因公司产品销售结构发生变化，不同产品回款周期不同，账期长的应收账款占比增加，导致公司长期应收款余额增加。虽然公司与主要客户形成了良好合作关系，且评估商业信誉较好，但如果未来受宏观经济形势和市场环境变化、客户自身经营情况变动等因素的影响，客户财务状况恶化，不能及时或无力支付货款时，公司将面临应收账款发生坏账损失的风险，对公司经营业绩及现金流造成不利影响。应对措施：1、加大客户信用管控及应收账款催收力度，要求客户按合同约定回款，专人跟进应收款催收，确保实时跟踪每笔应收账款情况；2、根据行业及客户性质将客户应收款进行分类管理，建立销售合同和回款档案，设专人进行日常登记和更新维护，定期向销售责任人通报应收账款进展；3、将客户应收账款的回收情况纳入销售部门的考核体系，以提升回款率，降低应收账款回收的风险；4、关注主要应收账款客户的经营情况，定期评价客户信用状况，加强客户的风险评估，同时，进一步优化客户结构，提升客户群体信用质量。感谢

您的关注！

**14、贵司在互动平台多次提到“公司为华为提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备等设备及技术服务支持”，请问这个”“华为”是否有涉及其子公司“华为海思”，麻烦正面回答，谢谢**

答：您好！公司主要产品为锡膏印刷设备、点胶设备、封装设备和柔性自动化设备。其中，锡膏印刷设备、点胶设备及柔性自动化设备应用于电子工业制造领域的电子装联环节，下游应用广泛，可应用于消费电子、汽车电子、网络通讯、航空航天、医疗器械、智能家居等行业的生产制造。封装设备主要应用于电子工业制造领域的封装环节及半导体封装环节，可应用于 LED 照明及显示器件、半导体芯片封装环节。公司产品性能已达到或超越国际顶尖厂商水平，获得了包括富士康、立讯精密、华为、鹏鼎控股、比亚迪、中国中车、吉利汽车、海康威视、京东方、木林森等各下游领域龙头客户的订单和认可，从而积累了庞大且优质的客户资源，获取了行业内的品牌知名度。公司在全球七十多个国家和地区注册了商标“GKG”，产品销往全球五十多个国家与地区。感谢您的关注！

**15、公司锡膏印刷设备的实力如何啊？**

答：您好！公司的锡膏印刷设备的竞争力主要体现在以下几点：

（1）公司从创立之初就注重研发中心的建设与完善，以共性技术研发为基础平台，结合创新型矩阵式产品管理孵化体系，致力于把研发中心打造成产品孵化中心。研发中心下设七大共性技术模块，包括软件工程、图像工程、运动控制、机械工程、电气工程、CAE 工程和系统集成这七大共性模块为基础，制定垄断性产品和高技术产品为研发方向，结合市场工艺需求，以项目模式落地。公司在面对客户时，提供的

不仅仅是锡膏印刷设备，而是一整套锡膏印刷解决方案。

(2) 随着电子装联工艺需求向小型化、复杂化发展，电子元器件的尺寸越来越小、IC 集成度越来越高，对锡膏印刷机的精度、稳定性和印刷工艺要求更高。公司的锡膏印刷设备其对准精度、印刷精度等关键技术指标已处于全球行业领先水平，并能满足不同规格元器件印刷工艺要求。

(3) 除了为客户提供高稳定性、高精度的设备，公司还会为客户提供全套印刷解决方案和 24 小时快速及时的售后服务。面对国内市场，公司在全国共设立了 18 个服务网点，全面覆盖国内各区域客户，能够快速响应客户的需求，为客户提供高质量服务。面对海外市场，依托新加坡子公司 GKG ASIA 覆盖并由其为海外客户提供技术支持与服务，子公司在马来西亚、越南、印度、墨西哥等电子行业集中的境外市场区域设立了服务网点，为海外客户提供优质服务。

(4) 锡膏印刷设备在整个 SMT 产线投资中所占份额较小，但是重要性很高，电子产品 SMT 组装过程中大概 60-70% 的品质缺陷是由于锡膏印刷不良引起的。所以下游大客户会非常谨慎地选择锡膏印刷设备的供应商，对设备品质、供应商品牌和售后服务的要求极高而对价格的敏感性较低，一旦选定了锡膏印刷设备的供应商，不会轻易进行更换。感谢您的关注！

**16、请问公司发展计划与愿景？近两年公司利润一直下降，是什么原因？怎么来增加公司利润提高广大股民的期望？**

答：1、公司的愿景是成为最具竞争力的精密自动化装备制造和服务提供商。秉承着“卓越品质是价值与尊严的起点，满足客户是创新与发展的源泉”的价值理念，坚定落实公司“共享技术平台+多产品+多领域”的研发布局，实现公司产品从单个“单项冠军”迈向多个“单项冠军”的战略。

2、净利润同比下降，主要系营收结构变化导致综合毛利率

的下降，毛利率较高的锡膏印刷设备营收占比较去年同期下降，毛利率较低的封装设备营收占比较去年同期上升。同时，报告期内软件退税、政府补助减少，长期应收款余额增加导致的计提坏账准备增加对利润也有一定影响。

3、未来产品发展规划方面：首先，巩固单项冠军锡膏印刷设备的市场领导地位，持续优化产品，推进产品迭代升级，继续保持产品品质、工艺方案及技术支持等多方面的竞争优势。其次，在传统LED固晶机出货量取得突破之后，继续推进产品优化及供应链降本增效，扩大交付边际效应，提升产品毛利率。技术的沉淀、产品的升级增强了点胶设备的核心竞争力，公司充分发挥品牌影响力及客户协同效应，稳步提升市场占有率。最后，增加应用于泛半导体及半导体产品的资源投入，积极引进行业专业人才提高产品性能，提升新产品的开发能力。感谢您的关注！

**17、公司目前不派发现金红利，请问未来是否有分红计划或其他形式的股东回报？**

答：您好！公司将根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况和盈利水平，以及未来的经营发展计划等综合因素拟定利润分配的方案。如果后续有利润分配方案，将按照相关法律法规等规定进行及时披露。

公司前次利润分配情况如下：公司2023年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共计派发现金红利1,702.40万元（含税），占2023年归属于上市公司股东净利润的32.38%，公司2023年度权益分派已于2024年5月28日实施完毕。详情请见公司《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-015），感谢您的关注！

**18、公司未来的发展规划和战略方向具体是什么？**

答：您好！公司是国家级高新技术企业，荣获国家制造业单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业，国家知识产权示范企

	<p>业、广东省博士后创新实践基地等称号，拥有“广东省精密机械工程技术研究中心”，“广东省电子器件生产装备 CAE 应用技术企业重点实验室”。</p> <p>公司主要产品为锡膏印刷设备、点胶设备、封装设备和柔性自动化设备。公司秉承着“卓越品质是价值与尊严的起点，满足客户是创新与发展的源泉”的价值理念，始终将技术创新作为公司可持续发展的基石，一方面持续创新优化现有技术，提升产品性能，完善公司核心技术体系；另一方面结合产品及行业发展趋势，在现有技术基础上往高端制程延展，挖掘创新点，进行技术储备。公司坚定落实“共享技术平台+多产品+多领域”的研发布局，实现产品从单个“单项冠军”迈向多个“单项冠军”的战略。</p> <p>首先，巩固单项冠军锡膏印刷设备的市场领导地位，持续优化产品，推进产品迭代升级，继续保持产品品质、工艺方案及技术支持等多方面的竞争优势。其次，在传统 LED 固晶机出货量取得突破之后，继续推进产品优化及供应链降本增效，扩大交付边际效应，提升产品毛利率；充分发挥公司固晶机在芯片小型化趋势上设备效率及稳定性的竞争优势，加大力度拓展 Mini/Micro LED 固晶机客户，提升市场占有率。技术的沉淀、产品的升级增强了点胶设备的核心竞争力，公司充分发挥在电子装联行业的品牌影响力及客户协同效应，稳步提升市场占有率。最后，增加应用于泛半导体及半导体产品的资源投入，积极引进行业专业人才提高产品性能，提升新产品的开发能力和渠道拓展能力。通过公司现有及潜在半导体客户群体，获得技术对接的机会，增加产品供应品类。拓展锡膏印刷、点胶、固晶等设备的功能，向半导体封装领域延展。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无

日期	2024 年 9 月 6 日
----	----------------